



行业动态
Industry News



6月北美半导体设备市场订单额10.3亿美元 出货比0.85

2008-08-01 | 编辑: | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

SEMI日前公布了2008年6月份北美半导体设备制造商订单出货比报告。按三个月移动平均额统计,6月份北美半导体设备制造商订单额为10.3亿美元,订单出货比为0.85。订单出货比为0.85意味着该月每出货价值100美元的产品可获得价值85美元的订单。

报告显示,6月份10.3亿美元的订单额与5月份10.3亿美元最终额持平,比2007年6月份的16.1亿美元最终额减少36%。

| | 出货量(三月平均) | 订单量(三月平均) | 订单出货比 |
|-----------------|-----------|-----------|-------|
| 2008年1月 | 1,279.30 | 1,141.00 | 0.89 |
| 2008年2月 | 1,310.80 | 1,205.40 | 0.92 |
| 2008年3月 | 1,344.90 | 1,165.60 | 0.87 |
| 2008年4月 | 1,337.30 | 1,090.30 | 0.82 |
| 2008年5月 (最终) | 1,312.60 | 1,030.40 | 0.79 |
| 2008年6月 (初步) | 1,211.90 | 1,029.80 | 0.85 |

与此同时,2008年6月份北美半导体设备制造商出货额为12.1亿美元,比5月份13.1亿美元的最终额减少8%,比2007年6月份17.7亿美元的最终额减少31%。

“今年上半年(1月至6月)北美设备制造商的订单额比去年同期减少27%。”SEMI产业研究分析高级主管Daniel Tracy说道,“半导体产业正在等待更明朗的经济环境以增加资本支出。”

(来源:国际电子商情 2008年7月23日)

▣ 科普首页

▣ 微电子历史

▣ 行业动态

▣ 术语解释

▣ 无微不至

▣ 芯片制程

▣ 科普创意